

消费电子

证券研究报告

2025 年 03 月 23 日

腾讯&中国移动发布 24 年报、GTC 召开，看好全球算力投资

英伟达 GTC：GTC 大会召开，主题锁定 Agentic AI、机器人和自动驾驶技术等，核心看好架构升级。1、GPU 架构升级，可实现 1.8TB/s 的片间互联带宽，拥有 15PF 的稠密 FP4 算力，比 GB200 高出 1.5 倍。2、预告下一代 AI 芯片架构“Rubin”和定制 CPU“Vera”，Vera Rubin 的整体性能是 GB300 的 3.3 倍。3、发布面向工作站和服务器的 RTX PRO 系列 Blackwell 专业卡。4、推出硅光芯片，Nvidia Dynamo 开源软件。5、Agentic AI 意味着 AI 有了自己的“代理”，具备推理的能力。6、推出世界首个开放、可定制的通用人形推理和技能基础模型 Isaac GR00T N1、专为机器人开发而构建的开源物理引擎 Newton 及 NVIDIA DGX Spark。7、发布英伟达 Halos，聚焦基于 AI 的端到端自动驾驶汽车堆栈。

算力投资：腾讯宣布进入 AI 重投入期，中国移动 25 年计划算力投资 373 亿元。随着 AI 能力和价值的逐步显现，腾讯加大了 AI 投资，以满足内部业务需求、训练基础模型，并支持日益增长的推理需求；2024 年资本支出大幅增加，主要用于采购更多 GPU，以满足推理需求以及云服务的扩展。2025 年腾讯计划进一步增加资本支出，继续投资于自研模型，并加速各业务集团 AI 应用的开发。中国移动 2025 年公司计划在算力领域投资 373 亿元，占资本开支的比例提升到 25%；通算规模（FP32）累计达到 8.9 EFLOPS，智算规模（FP16）超 34 EFLOPS。中国移动积极落实国家“东数西算”工程部署，构建技术和规模全面领先的全国性算力网络，算网大脑实现全国规模商用。

端侧 AI：以 AI 眼镜为代表的 AI 端侧产业事件密集，看好端侧 AI 需求起量。市场对于智能可穿戴设备的关注度不断提高，2025 年也被视作 AI 眼镜的爆发元年，全球 AI 眼镜市场开始迈入高速增长的黄金赛道，国内 AI 眼镜即将迎来 1-10 快速放量阶段。3 月 21 日，2025 亚洲 AI 智能眼镜大会于在深圳举行：华为、小米等 20 多家展商参展，展示 50 多个智能眼镜方案；阿里举行通义 AI 火花会，可能会发布阿里最新的 AI 终端产品。3 月 25 日，深圳将举办全球 AI 眼镜创新技术趋势论坛，聚焦 AI 眼镜产业链上下游技术、市场趋势与商业合作；会上将发布《2025 年 AI+AR 眼镜产业报告》及《AI+AR 眼镜产业图谱 2025 版》，覆盖芯片、显示、光学等关键领域。3 月 26 日，2025 年万亿 AI 智能眼镜产业趋势峰会将在深圳举行，以“AI+融合、智能视界”为主题，共同探讨智能穿戴未来发展之道。

华为召开 Pura 先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会：华为推出首款原生鸿蒙正式版的折叠屏手机，其搭载 16:10 阔型屏（6.3 英寸内屏）与 3.5 英寸 1.1 外屏，首次全面搭载 HarmonyOS 5。Rura X 在整机性能和可视面积、可显面积上都有所提升。华为还发布全产品线多款新产品，FreeBuds 6 耳机、手环 10、智慧屏 S6 Pro，以及华为悦影家庭影院。此外，鸿蒙智行三款新车亮相：2025 款 M9，问界新 M5 Ultra 发布，享界 S9 增程版启动预售。并公布了鸿蒙 HarmonyOS 5 升级计划。

智驾：Robotaxi 落地在即，技术引领商业模式裂变。Robotaxi 具有的安全、价格、高级别智驾三大优势是消费者在决定使用 Robotaxi 的最重要的三要素。在商业模式上，Robotaxi 对应的共享经济模式将引领全球 Robotaxi 市场商业模式发生质变。Robotaxi 市场有较大潜力：FrostSullivan 预测 Robotaxi 将于 2026 年左右实现规模化落地，随后进入全球扩张阶段，在 2030 年在全球范围内广泛采用。届时 Robotaxi 在中国智慧出行的渗透率将达到 31.8%，并在 2035 年左右提升至 69.3%。预计到 2030 年，中国与全球 Robotaxi 的市场规模将分别达 4888 亿元和 8349 亿元。

面板：2025 年 3 月电视面板价格涨势收敛，大尺寸液晶电视面板需求强劲。2025 年 3 月下旬，电视面板价格涨势收敛；显示器面板有望全面涨价，且涨幅稍扩大；笔电面板价格仍持平。面积增长比出货量增长收益效应更明显，面板出货面积呈增加趋势。据 Omdia 预测，85 英寸及以上的液晶和 OLED 电视以及公共显示器出货量将在 2025 年增长 34%，而 100 英寸及以上的液晶电视显示屏出货量将首次超过 100 万台。大尺寸液晶电视面板需求强劲，面板厂商对其 8.5 代、8.6 代和 10.5 代产线的产品组合进行调整，采取扩展现有 10.5 代 TFT 产线的产能、8.5 代和 8.6 代产线生产更多液晶电视面板、增加三种套切生产方式以及 10.5 代和 8.5/8.6 代产线的产品组合转变等措施生产大尺寸面板。

建议关注：消费电子零部件&组装：工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、蓝思科技、博硕科技、鹏鼎控股、歌尔股份、长盈精密、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子（港股）、东山精密、德赛电池、欣旺达（与电新组联合覆盖）、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电（机械组覆盖）、比亚迪电子（港股）、智迪科技、雷柏科技；消费电子材料：创新新材（与金属材料组联合覆盖）、思泉新材、中石科技、福蓉科技、世华科技；连接器及线束厂商：连接器及相关：立讯精密、华丰科技、中航光电（与军工组联合覆盖）、鼎通科技（通信组覆盖）、博威合金；线束：沃尔核材、新亚电子、兆龙互连、金信诺、电连技术；被动元件：上游原材料：洁美科技、国瓷材料；MLCC：三环集团、风华高科、达利凯普；电感：顺络电子、麦捷科技、铂科新材（金属材料组覆盖）；晶振：泰晶科技、惠伦晶体；面板：京东方、TCL 科技、彩虹股份、深天马 A、联得装备（与机械组联合覆盖）、精测电子、奥来德、鼎龙股份（与基础化工组联合覆盖）、莱特光电（化工组覆盖）、清溢光电、菲利华、深科达、硕中科技、汇成股份、新相微、天德钰、韦尔股份、中颖电子、易天股份；CCL&铜箔&PCB：建滔积层板、生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、中英科技、嘉元科技（电新组和金属材料组联合覆盖）、诺德股份、德福科技、方邦股份、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、兴森科技、沪电股份（与通信组联合覆盖）、景旺电子、胜宏科技；消费电子自动化设备：科瑞技术、智立方、思林杰、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴原创、博杰股份、荣旗科技、天准科技（电新组与机械组联合覆盖）、凌云光、精测电子、博众精工（机械组覆盖）；品牌消费电子：传音控股、漫步者、安克创新（与家电组联合覆盖）、小米集团（港股）；折叠屏产业链：东睦股份（金属材料组与机械组联合覆盖）、精研科技、统联精密、科森股份、凯盛科技（与建筑建材组联合覆盖）、长信科技、长阳科技、汇顶科技；汽车电子：电连技术、水晶光电、舜宇光学科技、联创电子、裕太微、和而泰、科博达、德赛西威（计算机与汽车组联合覆盖）、泰电电控、油泉泵（与汽车组联合覆盖）、华阳集团、东软集团（与计算机组联合覆盖）、保隆科技（汽车组覆盖）、速腾聚创、禾赛科技、图达通、四维图新、百度集团（海外组覆盖）、地平线、黑芝麻智能、经纬恒润、伯特利（汽车组覆盖）、中鼎股份、天润工业、中科创达、诚迈科技、小鹏汽车（汽车组与海外组联合覆盖）、理想汽车（汽车组与海外组联合覆盖）、蔚来、上汽集团、比亚迪（汽车组与电新组联合覆盖）；自动驾驶：禾赛科技、图达通、四维图新、百度集团（海外组覆盖）、地平线、黑芝麻智能、德赛西威、华阳集团、东软集团（与计算机组联合覆盖）、经纬恒润、保隆科技（汽车组覆盖）、伯特利（汽车组覆盖）、大华股份、海康威视

风险提示：地缘政治带来的不可预测风险，需求复苏不及预期，技术迭代不及预期，产业政策变化风险

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《消费电子-行业研究周报:GTC 大会召开在即,看好 GB300 性能飞跃及供应链机遇》 2025-03-15
- 2 《消费电子-行业点评:DeepSeek-R1 降本增效,看好 ASIC 赛道及应用端弹性释放》 2025-02-09
- 3 《消费电子-行业研究周报:英伟达系列产品发布完善 AI 生态网,看好物理 AI 赋能产业革新》 2025-01-13

内容目录

1. 周观点：腾讯&中国移动发布 24 年报、GTC 召开，看好全球算力投资.....	4
1.1. 英伟达：2025 GTC 大会于本周召开，NV 或将提早于二季度推出 GB300，看好其出货量及 NV 链修复	4
1.2. 算力投资：腾讯宣布进入 AI 重投入期，中国移动 25 年计划算力投资 373 亿元。	8
1.2.1. 腾讯：宣布进入 AI 重投入期，2024 年研发投入达 706.9 亿元	8
1.2.2. 中国移动：算网大脑实现全国规模商用，25 年计划算力投资 373 亿元	9
1.3. AI 眼镜：以 AI 眼镜为代表的 AI 端侧产业事件密集，看好端侧 AI 需求起量	9
1.4. 华为：Pura X 亮相，全场景生态再升级	11
1.5. Robotaxi：商用在即发展，技术引领商业模式裂变	14
1.6. 面板：3 月电视面板价格涨势收敛，大尺寸液晶电视面板需求强劲	15
2. 本周（3/14~3/21）消费电子行情回顾.....	18
3. 风险提示.....	22

图表目录

图 1：B300 和 B200 对比	4
图 2：Rubin UltraNVL576 介绍	5
图 3：DGX Spark 图	5
图 4：GTC 上展示的两款硅光共封芯片 Quantum-X、Spectrum-X 参数	6
图 5：Blackwell 25X Hopper 性能图	7
图 6：Isaac GROOT N1 介绍图	7
图 7：腾讯 AI 渗透网络	8
图 8：中国移动升级泛在融合的算力网络	9
图 9：2025 年全球及中国 AI 眼镜出货量预测趋势图	9
图 10：2025 亚洲 AI 智能眼镜大会	10
图 11：全球 AI 眼镜创新技术趋势论坛	10
图 12：Pura X 手机图	12
图 13：FreeBuds 6 悦彰耳机	12
图 14：WATCH GT 5	12
图 15：华为手环 10	12
图 16：华为 S6 Pro 智慧屏	13
图 17：2025 款问界 M9	14
图 18：Robotaxi 企业综合格局	14
图 19：2025 年 3 月面板价格	15
图 20：京东方（BOE）采用新的电视面板 MMG 套切方法示意图	16
图 21：中国大陆液晶面板厂商新增三种套切生产方式示意图	16
图 22：中国大陆液晶面板厂商将利用 8.5 代线和 10.5 代线工厂生产超大尺寸电视面板	17
图 23：京东方和华星光电可能的产品组合变化，8.5 代-10.5 代	17

图 24：申万电子行业指数和沪深 300 指数对比.....	18
图 25：道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数对比.....	19
图 26：恒生指数与恒生科技指数对比	19
图 27：中国台湾加权指数和中国台湾电子行业指数对比	20
图 28：本周（3/14~3/21）A 股各行业行情对比	21
图 29：本周（3/14~3/21）电子各子版块涨跌幅	21
表 1：AI 眼镜相关企业产品发布情况.....	10
表 2：本周（3/14~3/21）消费电子行情与主要指数对比	20
表 3：本周（3/14-3/21）消费电子板块涨跌幅前十的个股	21

1. 周观点：腾讯&中国移动发布 24 年报、GTC 召开，看好全球算力投资

1.1. 英伟达：2025 GTC大会于本周召开，NV 或将提早于二季度推出 GB300，看好其出货量及 NV 链修复

英伟达推出新产品“Blackwell Ultra”。它基于一两年前推出的 Blackwell 架构，结合 NVIDIA GB300 NVL72 机架级解决方案和 NVIDIA HGX B300 NVL16 系统。新机架级解决方案的性能是 NVIDIA GB200 NVL72 的 1.5 倍；AI 工厂收入机会增加 50 倍。Blackwell Ultra 由两颗台积电 N4P（5nm）工艺，Blackwell 架构芯片+Grace CPU 封装而来，并且搭配更先进的 12 层堆叠的 HBM3e 内存，显存提升至为 288GB，和上一代一样支持第五代 NVLink，可实现 1.8TB/s 的片间互联带宽，拥有 15PF 的稠密 FP4 算力，比 GB200 高出 1.5 倍。Blackwell Ultra 芯片能够单个购买。

图 1：B300 和 B200 对比

Nvidia Blackwell Ultra B300 vs Blackwell B200

Platform	B300	B200	B100
Configuration	Blackwell GPU	Blackwell GPU	Blackwell GPU
FP4 Tensor Dense/Sparse	15/30 petaflops	10/20 petaflops	7/14 petaflops
FP6/FP8 Tensor Dense/Sparse	7.5/15 petaflops ?	5/10 petaflops	3.5/7 petaflops
INT8 Tensor Dense/Sparse	7.5/15 petaops ?	5/10 petaops	3.5/7 petaops
FP16/BF16 Tensor Dense/Sparse	3.75/7.5 petaflops ?	2.5/5 petaflops	1.8/3.5 petaflops
TF32 Tensor Dense/Sparse	1.88/3.75 petaflops ?	1.25/2.5 petaflops	0.9/1.8 petaflops
FP64 Tensor Dense	68 teraflops ?	45 teraflops	30 teraflops
Memory	288GB (8x36GB)	192GB (8x24GB)	192GB (8x24GB)
Bandwidth	8 TB/s ?	8 TB/s	8 TB/s
Power	?	1300W	700W

资料来源：半导体行业观察公众号

根据 TrendForce 集邦咨询最新 AI Server 供应链调查，预期 NVIDIA（英伟达）将提早于 2025 年第二季推出 GB300 芯片。思科、戴尔、惠普、联想、超微电脑等将提供基于 Blackwell Ultra 产品的各种服务器，亚马逊 AWS、谷歌云、微软 Azure 等也将提供 Blackwell Ultra 的相关云服务。黄仁勋在活动中推出一款名为“DGX Station”的台式电脑，该电脑搭载单个 GB300 Grace Blackwell Ultra 和 784GB 内存，ConnectX-8 SuperNIC 支持高达 800Gb/s 的网络。目前使用 Blackwell GB200 的客户，也都可以平滑切换到 Blackwell Ultra。

英伟达预告下一代 AI 芯片架构“Rubin”和定制 CPU“Vera”，对标现在的 Blackwell 和 Grace CPU。从预览的性能来看，Vera Rubin 的整体性能是 GB300 的 3.3 倍，集 288GB HBM4、13TB/s 带宽、260TB/s 吞吐量于一身。其性能可达 Hopper 的 900 倍，而 Blackwell 是 Hopper 的 68 倍。在预览 Rubin 的同时，还前瞻更为强悍的 Rubin Ultra

NVL576, 拥有 365TB 带宽 4.6PB/s 的 HBM4e 内存, 性能拉到 GB300 的 14 倍。

Rubin Ultra 将采用 NVL576 机架配置, 并配备带有四个标线大小芯片的独立 GPU, 也就是将四个芯片组合成一个芯片, 使 Rubin 的速度翻倍, 每个芯片可提供 100 petaflops 的 FP4 精度, 在机架层面, Rubin Ultra 将提供每秒 15 exaflops 浮点运算的 FP4 推理计算和每秒 5 exaflops 浮点运算的 FP8 训练性能, 比 Rubin NVL144 配置强大约四倍。每个 Rubin Ultra GPU 将包含 1TB 的 HBM4e 内存, 整个机架包含 365TB 的快速内存。NVLink7 接口速度将比 Rubin 接口快 6 倍, 吞吐量为 1.5 PB/s。CX9 互连也将实现机架间 115.2 TB/s 的 4 倍提升。

图 2: Rubin Ultra NVL576 介绍



资料来源: 半导体行业观察公众号

对于那些现阶段 Blackwell Ultra NVL72 都不能满足需求, 又不需要搭建超大规模 AI 集群的客户, 英伟达的解决方案是基于 Blackwell Ultra、即插即用的 DGX Super POD AI 超算工厂。DGX Super POD 主要面向专为生成式 AI、AI Agent 和物理模拟等 AI 场景, 覆盖从预训练、后训练到生产环境的全流程算力扩展需求, Equinix 作为首个服务商, 提供液冷/风冷基础架构支持。搭载 GB10 芯片, FP4 精度下算力可以达到 1PetaFlops, 内置 128GB LPDDR5X 内存, CX-7 网卡, 4TB NVMe 存储, 且预装英伟达提供的一些基础 AI 软件开发工具, 可以运行 2000 亿参数模型。

英伟达正式发布面向工作站和服务器的 RTX PRO 系列 Blackwell 专业卡。之前在 CES 上发布的 Project DIGITS 迷你主机, 现已正式定名为 DGX Spark, 仅需 3000 美元即可获得 1000 TFLOPS 的 AI 算力, DGX Station 搭载一颗 GB300 超级芯片, 拥有 784GB 统一内存, AI 算力高达 20,000 TFLOPS。旗舰级的 RTX PRO 6000 系列拥有 24,064 个 CUDA 核心、752 个 Tensor 核心、188 个 RT 核心。英伟达的 Blackwell DGX 系统创下 DeepSeek-R1 大模型推理性能的世界纪录。可实现每用户每秒超 250 token 的响应速度, 系统最高吞吐量突破每秒 3 万 token。

图 3: DGX Spark 图



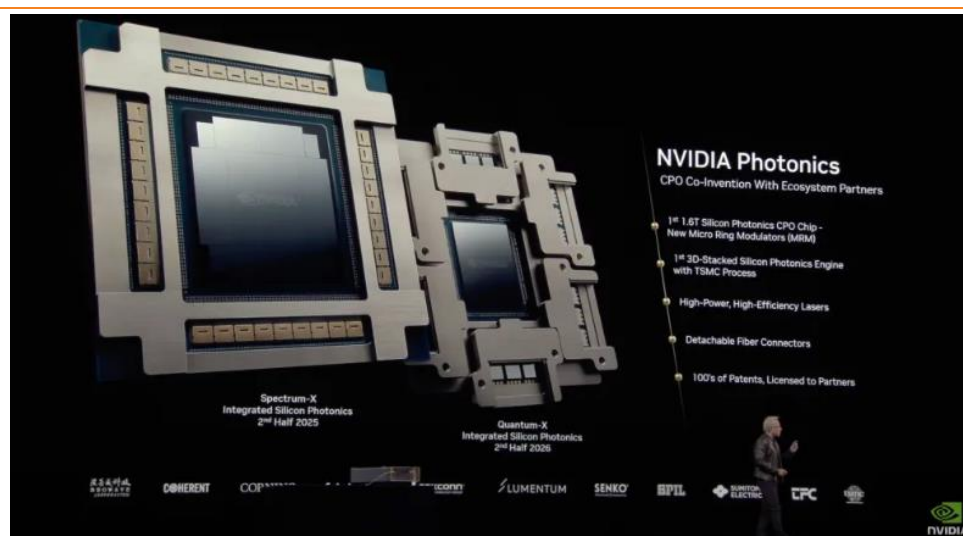
资料来源：IT之家公众号

英伟达将与几家电信行业引领企业建立合作伙伴关系，共同开发基于人工智能的 6G 无线技术。英伟达将与 T-Mobile、Mitre、思科、ODC 和 Booz Allen Hamilton 合作开发 AI 原生 6G 无线网络的硬件、软件和架构，将提供突破性的性能和资源利用率，同时为电信公司创造新的收入来源。英伟达表示，下一代无线网络必须从根本上与人工智能相结合，才能无缝连接数亿部手机、传感器、摄像头、机器人和自动驾驶汽车。

AI 原生无线网络将为数十亿用户提供增强服务，并在频谱效率方面设定新标准。电信企业将合作在 NVIDIA AI Aerial 平台上为 6G 构建 AI 原生网络堆栈。美国电信巨头 T-Mobile 和英伟达将扩大 AI-RAN（人工智能无线接入网）创新中心的合作。

英伟达推出 Quantum-X 硅光共封芯片、Spectrum-X 硅光共封芯片以及衍生出来的三款交换机产品。英伟达公布其采用硅光子学并在其 Quantum InfiniBand 和 Spectrum Ethernet 系列交换机中部署共封装光学器件 (CPO) 的计划，事实证明它将在很大程度上降低数据中心规模 AI 系统中网络的功率需求。这是一个基于 CPO 合作伙伴生态共创研发的平台，将在很大程度上降低数据中心规模 AI 系统中网络的功率需求。英伟达选择的方案将有 240 万个光收发器，采用两种不同的共封装光学器件方法。

图 4：GTC 上展示的两款硅光共封芯片 Quantum-X、Spectrum-X 参数



资料来源：腾讯科技公众号

整合光模块的 Photonics 交换机相比传统交换机，性能提升 3.5 倍，其每端口可提供 1.6 太比特每秒速度，能为 AI 工厂节省 3.5 倍能源，部署效率可以提升 1.3 倍，以及 10 倍以上的扩展弹性。在光学技术上创新，减少激光器使用，提升能效、信号完整性。